

씨앤지하이테크-한국과학기술연구원,

방열기판 산업 진출 위한 기술 협력 조인식 체결

▶ Cu/AlN복합체 기술 사용... 반도체, 전자부품에 필수적인 방열기판 제조 사업 추진

▶ 반도체/디스플레이 장치 사업을 넘어 장기 성장 실현할 것

<2018-12-12> 씨앤지하이테크가 한국과학기술연구원과 손잡고 장기 성장플랜을 가동한다.

반도체/디스플레이 화학약품혼합공급장치 전문 기업 씨앤지하이테크(주)(264660, 대표이사 홍사문)는 11일 씨앤지하이테크 홍사문 대표이사과 한국과학기술연구원(KIST) 하헌필 미래융합기술연구본부장 등 관계자들이 참석한 가운데 양사의 기술 협력을 위한 조인식을 개최했다고 밝혔다.

조인식은 씨앤지하이테크가 신사업 추진을 위해 지난달 30일 한국과학기술연구원과 기술 실시 계약을 체결한 것을 기념하는 의미에서 진행됐다. 씨앤지하이테크는 한국과학기술연구원이 보유한 Cu/AlN복합체 기술을 사용해 방열기판 제조 사업을 시작할 예정이다.

Cu/AlN복합체 기술은 Cu(구리)의 접합이 용이하도록 AlN(질화 알루미늄) 표면을 개질하는 기술이다. 고방열 회로기판, 고집적화 전자소자의 방열기판, LED반도체의 방열기판 등을 제작하는 데 사용된다. 별도의 고가 장비가 필요하지 않아 여타 기술 대비 원가 경쟁력이 높다.

씨앤지하이테크는 한국과학기술연구원의 기술을 사용해 방열기판을 개발, 향후 3년 내 양산 및 판매에 돌입할 계획이다. 기존 반도체/디스플레이 장치 사업의 고객사 네트워크를 활용하는 등, 기존 사업과 신사업이 다방면에서 시너지를 창출할 것으로 기대된다.

최근 반도체칩의 고출력화에 따라 가전 분야는 물론 차세대 자동차 산업에서도 방열기판의 수요가 증가하고 있다. 특히 온도 변화는 전자소자에 고장이 발생하는 주 요인인 만큼, 소비자 안전과 직결되는 전자부품 시장에서 고방열소재에 대한 니즈가 크다. 일본의 시장조사기관 Japan Marketing Survey는 방열부품 산업이 지속 성장해 2018년 2조 1,400억 원 규모에 이를 것으로 전망했다.

씨앤지하이테크 홍사문 대표이사는 “올해 초 상장 후 기존 반도체/디스플레이 사업에서 꾸준한 성과를 창출하기 위해 노력하는 한편, 장기적으로 성장할 수 있는 새로운 사업을 다각적으로 모색해왔다”며 “한국과학기술연구원의 독보적 기술력을 활용한 방열기판 제조 신사업이 기업의 안정적 성장을 이끄는 견인차가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

☎ 자료문의: 씨앤지하이테크(주) 이재홍 이사 (031-654-9222), 이창호 과장 (031-659-9822)

(주)IR큐더스 김창훈 매니저 (070-5068-6321), 김물결 선임 (070-5068-6320)

[사진자료]



▶ (좌)씨앤지하이테크 홍사문 대표이사, (우)하헌필 미래융합기술연구본부장



▶ 씨앤지하이테크와 한국과학기술연구원 관계자들이 조인식 후 포즈를 취하고 있다.